

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-15

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>线上策略会</u> ）
参与单位名称及人员姓名（排名不分先后）	野村证券线上策略会、摩根士丹利线上策略会。
时间	2022年8月31日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	证券事务代表：谢丹。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流主要内容：</p> <p>Q1、请简要介绍公司2022年半年度经营业绩情况。</p> <p>在2022年上半年复杂的外部环境下，公司在持续做好疫情防控、稳健运营的基础上，实现营收总收入69.72亿元，同比增长18.55%；实现归母净利润7.52亿元，同比增长34.10%。公司三项业务营业收入均实现同比增长，其中PCB业务实现主营业务收入44.32亿元，同比增长19.56%，占公司营业总收入的63.57%，毛利率27.34%；封装基板业务实现主营业务收入13.66亿元，同比增长24.78%，占公司营业总收入收的19.60%，毛利率30.27%；电子装联业务实现主营业务收入7.07亿元，同比增长4.90%，占公司营业总收入的10.14%，业务毛利率17.64%。</p> <p>Q2、请介绍公司三大业务营收规模、毛利率均实现同比增长的原因。</p> <p>PCB业务主要得益于通信、数据中心、汽车电子领域贡献营收增长。此外，公司通过</p>

优化业务订单结构，提升高盈利产品占比，并积极推进产品质量优化和工厂运营效率提升，促进毛利率同比增长。

封装基板业务主要因无锡基板一期工厂产能爬坡扩大营收规模，摊薄单位产品固定成本，助益毛利率同比增长。

PCBA 业务主要因公司加大对非通信领域拓展力度，产品结构进一步优化促进营收增长。此外，公司通过加强精细化管理等内部精益改善工作，有效实现降本增效，推动业务毛利率同比增长。

Q3、请介绍公司目前 PCB 业务下游营收占比分布情况。

目前公司 PCB 业务下游以通信领域为主，数据中心、工控医疗、汽车电子占比持续提升。

Q4、请介绍公司 PCB 业务在通信领域拓展情况。

公司 PCB 业务长期深耕通信领域，覆盖各类无线侧及有线侧通信 PCB 产品。在 2022 年上半年国内通信市场需求保持平缓、海外通信市场需求持续增长的背景下，公司凭借行业领先的技术实力与高效优质的服务能力，在国内通信市场保持稳定份额，并持续深耕海外通信市场，海外通信业务占比有所提升。从中长期看，国内与海外市场仍存在较大的通信基础设施建设需求，通信市场整体具备良好发展前景。

Q5、请介绍公司 PCB 业务在数据中心领域拓展情况。

数据中心作为公司近年来新进入并重点拓展的领域之一，已对公司营收产生较大贡献，整体市场空间有待公司进一步开拓。2022 上半年，受益于服务器市场 Whitley 平台切换的推进，公司 Whitley 平台用 PCB 产品占比持续提升，促进数据中心领域营收规模增长。目前，公司已配合客户完成新一代 EGS 平台用 PCB 样品研发并具备批量生产能力。

Q6、请介绍公司 PCB 业务在汽车电子领域拓展情况。

汽车电子是公司 PCB 业务重点拓展领域之一。公司以新能源和 ADAS 为主要聚焦方向，主要生产高频、HDI、刚挠、厚铜等产品，其中 ADAS 领域产品比重相对较高，应用于摄像头、雷达等设备，新能源领域产品主要集中于电池、电控层面。2022 年上半年，

	<p>伴随公司加大对汽车电子市场开发力度及南通三期工厂连线爬坡，汽车电子营收规模同比实现翻倍增长，但目前占 PCB 整体营收比重相对较小。</p> <p>Q7、请介绍公司南通三期工厂产能爬坡及客户认证进展。</p> <p>南通三期工厂产能爬坡进展顺利。客户对南通三期认证审核进度正常有序推进，项目总体进展符合预期。</p> <p>Q8、请介绍公司封装基板业务产能布局情况及产品主要类型。</p> <p>公司现有深圳 2 家、无锡 1 家封装基板工厂，目前产能利用率保持较高水平。公司另有无锡基板二期工厂、广州封装基板项目处于建设过程中，其中无锡基板二期工厂预计 2022 年第四季度连线投产。公司封装基板业务已拥有较为先进的精细线路产品技术能力以及质量能力平台，目前量产产品均为 BT 类封装基板，主要包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片用封装基板；使用 ABF 材料的 FC-BGA 封装基板将在现有平台基础上进行深度孵化，目前处于样品研发阶段。</p> <p>注：调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单	无
日期	2022 年 9 月 2 日